**课题大额支出情况说明**

**事由：**

陶耀宇课题组主持的国自然基金委优秀青年科学基金（海外）项目“基于先进器件的软硬件协同芯片架构设计”，课题的下一步目标是基于先进ReRAM存算一体器件IP进行芯片架构设计与流片制造。该目标需要采购ReRAM存算一体器件IP与设计文件，包括芯片开发所需的PDK Lib、IP设计文档等，用于相关芯片设计与后续流片制造。

**金额：**

课题组做了大量前期了解，目前一套ReRAM PDK Lib与ReRAM IP设计文档的市场价格约为35.00-70.00万元（台积电TSMC代理价格约为70.00万元/套、厦门UMC联芯代理价格约为48.00万元/套）。燕芯微电子（上海）有限公司提供了基于国产自主可控工艺的全套ReRAM PDK Lib与IP设计文件，价格为35.00万元/套，在目前ReRAM PDK Lib与IP设计文件价格中具有显著优势；预计采购1套，总计35.00万元。

**拟出资来源：**

拟从纵向课题支出，项目名称全称为：基于先进器件的软硬件协同芯片架构设计，已到款140.00万元到课题组账户。

陶耀宇课题组

2025年8月6日